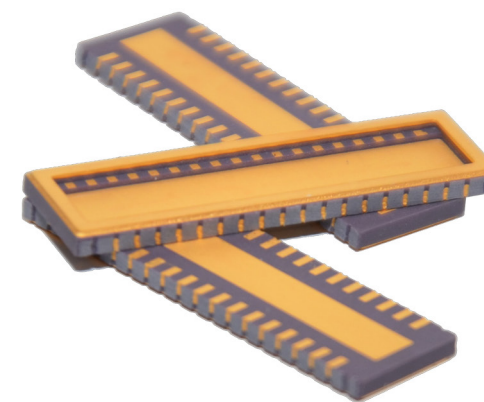
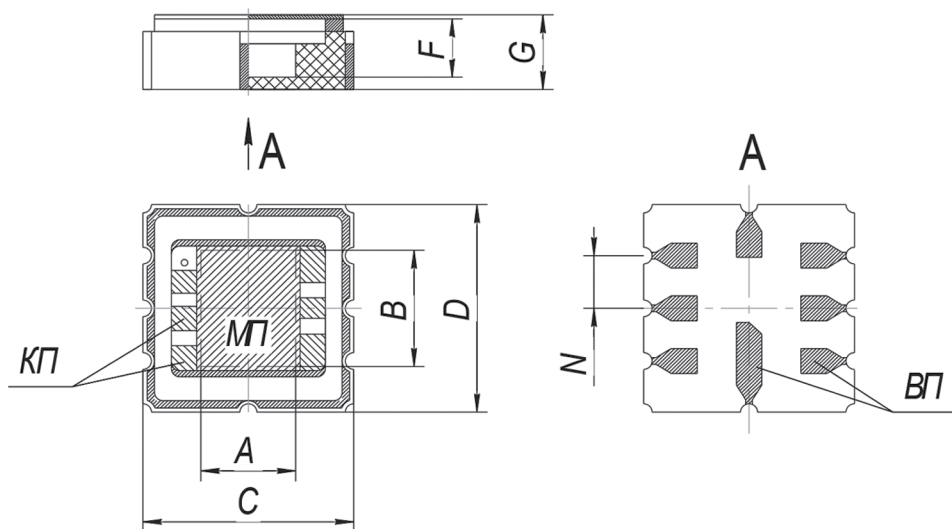


Условное обозначение	Количество контактных площадок	Количество выводных площадок	Шаг выводных площадок N, мм	Расстояние между основанием и крышной (под кристалл) F, мм min	Размер рабочей зоны А*В, мм min	Габаритные размеры платы С*Д, мм
DLCC 2/4-2	2	4	2,54	0,63	3,4*3,2	7*5
МК 5204,4-1 НЗ	2	4	3,7	0,5	2,6*1,7	5*3,2
МК 5204,4-2 НЗ	8	4	3,7	0,8	1,45*1,25	5*3,2
DLCC 8/4-1	8	4	5,08	1,01	1*1	7*5
DLCC 8/4-3	8	4	5,08	1,01	1*1	7*5
DLCC 9/4-1	9	4	5,08	1,01	1,7*1,35	7*5
DLCC 6/6-1	6	6	1,27	1,1	2,4*1,7	3,8*3,8
DLCC 6/6-3	6	6	2,54	0,9	5*2,5	7*5
DLCC 10/10-1	10	10	2,54	1,1	13,7*3,3	16*7,3
DLCC 14/10-1	14	10	1,905	1,3	11,7*4,3	14*8,2
DLCC 16/16-1	16	16	1,27	1,2	4,5*2,8	11*7,3
DLCC 10/18-1	10	18	1,27	1,2	13*3,5	15,34*6,55
DLCC 20/20-1	20	20	1,27	1,2	4,5*2,8	13,3*7,3
DLCC 20/20-4	20	20	1,27	1,3	12,9*5,6	17,5*9
DLCC 22/22-1 (МК 5131,22-1 НЗ)	22	22	1,5	1,3	16,7*3	19*6,5

Общая высота B, мм max	Масса, г	Монтажная площадка Металлизируемая - «+», Неметаллизируемая - «-»	Метод герметизации	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление проводников, Ом	Электрически соединены
1,35	0,144	-	сварка	10 ⁹	0,3	ВП 2, 4 – ободок, ВП 1 – проводник 5
1	0,05	-	сварка	10 ⁹	0,25	ВП 2,4 – ободок
1,3	0,06	+	сварка	10 ⁹	0,12	ВП 2 – МП – ободок
1,75	0,17	+	сварка	10 ⁹	0,12	ВП 2 – ободок, ВП 4 – МП
1,75	0,17	+	сварка	10 ⁹	0,12	ВП 2 – МП – ободок
1,75	0,17	+	сварка	10 ⁹	0,1	ВП 2 – МП – ободок
2,1	0,19	+	сварка	10 ⁹	0,07	ВП 1, 3, 4, 6 – МП – ободок
1,81	0,17	+	сварка	10 ⁹	0,1	ВП 5 – МП – ободок
2,7	1	+	сварка	10 ⁹	0,1	ВП 3, 8 – МП – ободок
2,7	0,9	+	сварка	10 ⁹		ВП 3, 5, 10, 12 – МП – ободок
2,9	1,1	+	сварка	10 ⁹		ВП 1 – МП – ободок
2,3	1,1	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП 3 – 5, 7 – 9, 14 – 16, 18 – 20 – МП – ободок
2,9	1,2	+	сварка	10 ⁹		ВП 1 – МП – ободок
3	1,63	-	сварка	10 ⁹	0,7	ВП 20 – ободок
2,35	0,64	+	сварка	10 ⁹	0,08	ВП 23 – МП – ободок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МП - монтажная площадка, КП - контактная площадка,
ВП - выводная площадка.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МП - монтажная площадка, КП - контактная площадка,
ВП - выводная площадка.

Условное обозначение	Количество контактных площадок	Количество выводных площадок	Шаг выводных площадок N, мм	Расстояние между основанием и крышкой (под кристалл) F, мм min	Размер рабочей зоны А*В, мм min	Габаритные размеры платы С*D, мм
DLCC 36/36-1	36	36	1,27	1,15	23,7*4	26,2*8
SLCC 5/5-1	5	5	2,54	1,1	13,7*2,5	16*5,9
QLCC 4/8-1	4	8	2,54	0,89	сложная форма	7,24*7,24
QLCC 6/8-1 (5140,8-A H3)	6	8	1,27	1,07	2,25*2,8	5*5
QLCC 6/10-1	6	10	2,54	1,07	6,6*2,6	9,1*7,1
QLCC 6/10-2	6	10	1,27	0,96	5,5*2,5	7*5
QLCC 10/10-1	10	10	2,54	1,2	6,6*2,6	9,1*7,1
QLCC 10/10-2	10	10	2,54	1,2	6,8*3,75	9,1*7,1

Общая высота С, мм max	Масса, г	Монтажная площадка Металлизированная - «+», Неметаллизированная - «-»	Метод герметизации	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление проводников, Ом	Электрически соединены
2,08	1,42	+	сварка	10 ⁹	0,08	ВП 37- МП – ободок
2,7	0,6	+	сварка	10 ⁹	0,1	ВП 3 – МП – ободок
1,7	0,45	+	сварка	10 ⁹	0,07	ВП 1,4 – ободок
1,8	0,2	+	сварка	10 ⁹	0,16	ВП 4,8 – МП – ободок
2,05	0,53	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП а, с, d, e, f, h, j, k – МП – ободок
1,83	0,17	+	сварка	10 ⁹	0,12	ВП А, В, С, F, G, H – МП – ободок
2,05	0,53	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП k, d, e, j – МП – ободок
2,2	0,53	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП 4,5,9,10 – МП – ободок

Условное обозначение	Количество контактных площадок	Количество выводных площадок	Шаг выводных площадок N, мм	Расстояние между основанием и крышной (под кристалл) F, мм min	Размер рабочей зоны A*В, мм min	Габаритные размеры платы C*D, мм
QLCC 10/10-3	10	10	2,54	1,07	6,6*2,6	9,1*7,1
QLCC 8/12-2	8	12	2,54	1,05	9,6*4,6	13,3*6,5
QLCC 12/12-1	12	12	2,54	1,0	10,9*2,7	13,3*6,5
QLCC 14/15-1	14	15	1,27	1,1	13,2*2,6	15,3*6,45
QLCC 16/16-1 (МК 5130.16-А НЗ)	16	16	1,37	1,28	3*3	6,35*6,35
QLCC 16/16-2 (МК 5119.16-В)	16	16	1,27	1,16	3,5*3,5	7,6*7,6
QLCC 16/18-1	16	18	2,54	1,2	4,3*15,7	18*8,2
QLCC 20/20-1	20	20	1,27	1,35	4,6*4,6	8,9*8,9
QLCC 24/24-1	24	24	1,27	1,28	4,4*4,4	8,5*8,5
QLCC 24/24-2	24	24	1,0	1,13	3,8*3,8	7,2*7,2
QLCC 32/32-1	32	32	1,02	1,2	6*6	10,7*10,7
QLCC 40/40-1	40	40	0,5	0,8	4*4	6*6
5129.40-1	40	40	1	1,3	6,7*6,7	12*12
QLCC 40/40-2 (МК 5171.40-3)	40	40	0,5	0,74	4*4	6,3*6,3
МК 5165.44-1	44	44	0,5	0,74	4*4	6,3*6,3
QLCC 48/48-1	48	48	0,016	1,4	7,1*7,1	12,7*12,7
МК 5162.48-1	48	48	0,5	0,76	4*4	6*6
QLCC 64/64-1 (МК 5153.64-3)	64	64	0,7	1,08	10*10	13,8*13,8

Общая высота G, мм max	Масса, г	Монтажная площадка Металлизируемая - «+», Неметаллизируемая - «-»	Метод герметизации	Сопротивление изоляции не менее, Ом	Сопротивление проводников, Ом	Электрически соединены
2,05	0,53	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП b, d, e, g, j, k – МП – ободок
2,0	0,62	+	сварка	10 ⁹	0,4	ВП C, D, E, F, J, K, M, N – МП – ободок
1,9	0,77	+	сварка	10 ⁹	0,18	ВП 2,8,13 – МП1 – МП2 – ободок
1,9	0,5	+	сварка	10 ⁹	0,15	ВП C, E, K, M, R – МП – ободок
2,31	0,26	+	сварка	10 ⁹	0,2	МП, ободок изолированы
2,23	0,39	+	сварка	10 ⁹	0,08	МП, ободок изолированы
2,3	0,72	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП 2, 5, 8, 11, 14, 17 – МП – ободок
2,6	0,56	+	сварка	10 ⁹	0,09	МП, ободок изолированы
2,2	0,53	+	сварка	10 ⁹	0,13	МП, ободок изолированы
2,26	0,33	+	сварка	10 ⁹	0,08	ВП 1 – МП – ободок – радиатор
2,33	0,76	+	сварка	10 ⁹	0,12	МП, ободок изолированы
1,8	0,16	+	сварка	10 ⁸	0,1	МП – ободок – радиатор
2,5	1,2	-	сварка	10 ⁹	0,12	МП, ободок изолированы
1,88	0,2	+	сварка	10 ⁸	0,15	МП – ободок – радиатор
1,88	0,16	+	сварка	10 ⁸	0,2	МП – ободок – радиатор
2,47	0,91	+	сварка	10 ⁹	0,16	ВП 37 – МП – ободок
1,9	0,16	+	сварка	10 ⁹	0,2	ВП 6 – МП – ободок
2,05	1,03	+	сварка	10 ⁹	0,13	ВП 32 – ободок, МП – площадки с обратной стороны основания